

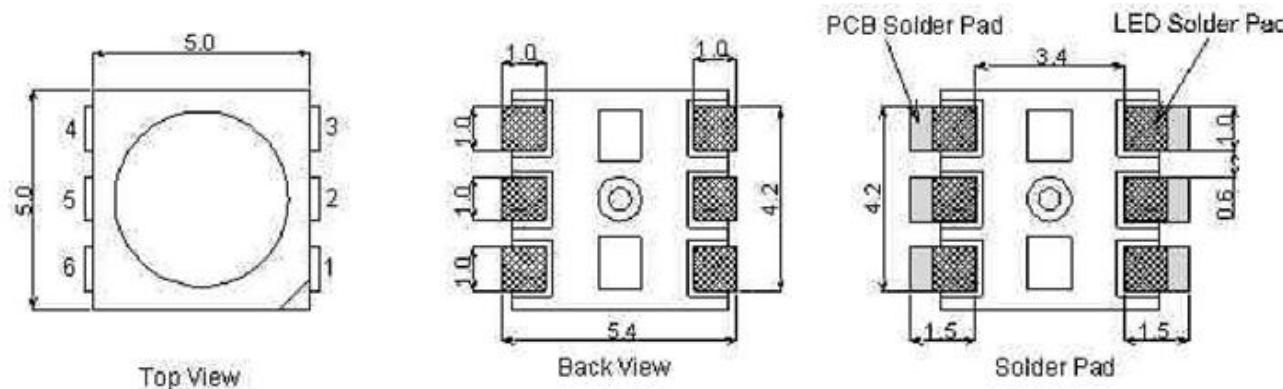
主要特点

- 使用三安原装正品芯片，RGB 芯片波长、亮度均为同 BIN 物料，颜色一致性高；
- 红铜支架，散热性好，质量可靠。
- 环氧树脂封装防硫化性能强，气密性好、透明度高、耐高温、光泽。
- 支架分为白色和黑色两种颜色，方便客户的选择。

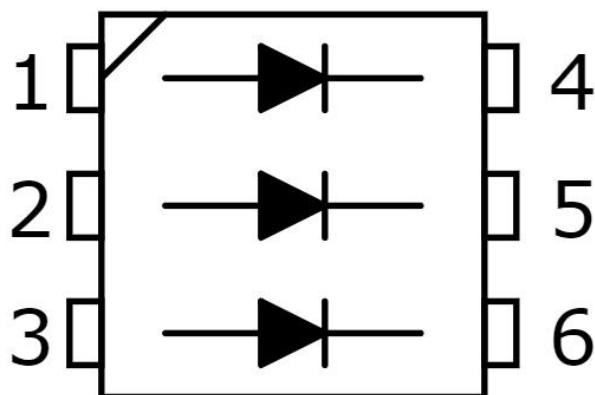
主要应用领域

- LED 发光字灯串
- LED 软灯条硬灯条
- LED 模组

机械尺寸



引出端排列



引出端功能

序号	符号	管脚名
1	B+	蓝光正极
2	R+	红光正极
3	G+	绿光正极
4	B-	蓝光负极
5	R-	红光负极
6	G-	绿光负极

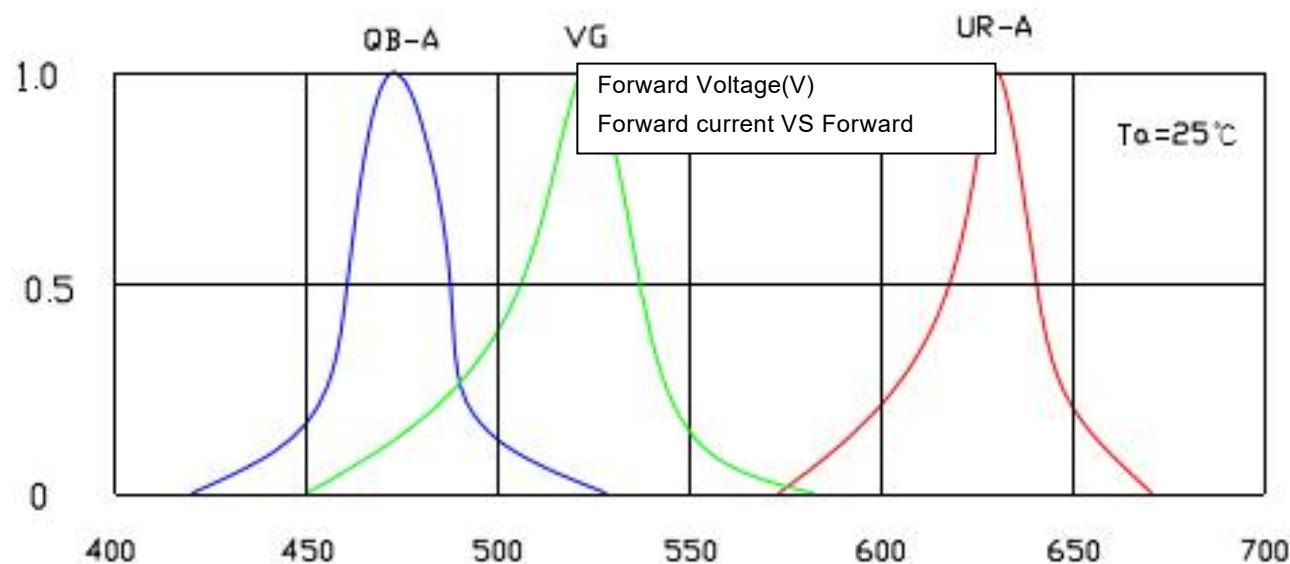
最大额定值 (TA=25°C)

参数	颜色	符号	最大额定值	单位
消耗功效	GB	Pd	100	mW
	R		75	
顺向电流	RGB	IF	20	mA
顺向峰值电流	R	IFP	50	mA
	GB		100	
反向电压	RGB	VR	5	V
焊接温度	RGB	tsol	245	°C
使用温度	RGB	Topr	-40~65	°C
储存温度	RGB	Tstg	-20~80	°C
IFP条件：脉冲不超过1/10周期及0.1ms宽度				

光电特性参数 (TA=25°C)

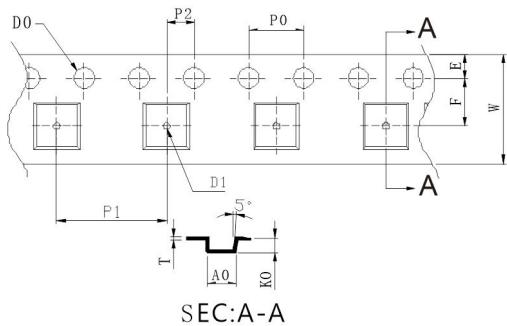
参数	颜色	单位	最小值	典型值	最大值	单位	条件	
顺向电压	GB	Vf	----	3.2	----	V	IF=20mA	
	R		----	2.0	----			
亮度	R	Iv	----	700	750	mcd		
	G		----	1400	1500			
	B		----	320	350			
发光角度	RGB	$\theta_{1/2}$	----	120	----	deg		
反向漏电	RGB	IR	----		10	uA	VR=5V	
主波长	R	λ_d	----	621	----	nm	IF=20mA	
	G		----	518	----			
	B		----	471	----			

典型光电参数曲线

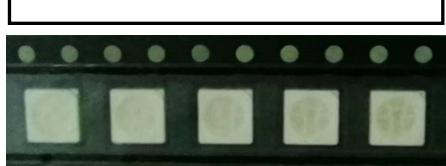


包装标准

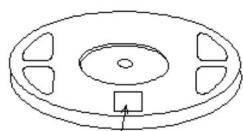
载带尺寸规格	
SYMBOL	SPEC.
W.	12.00±0.20
T.	0.25±0.02
A0	5.35±0.10
B0	5.75±0.10
K0	1.85±0.10
E	1.75±0.10
F	5.50±0.10
D0	1.60±0.10
D1	1.60±0.10
P1	8.00±0.10
P2	2.00±0.05
10*P0	40.00±0.20



编带方向: 缺边对载带圆孔

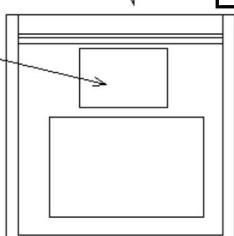


卷盘: 1K/盘: 167*12mm
4.5K/盘 327*12mm

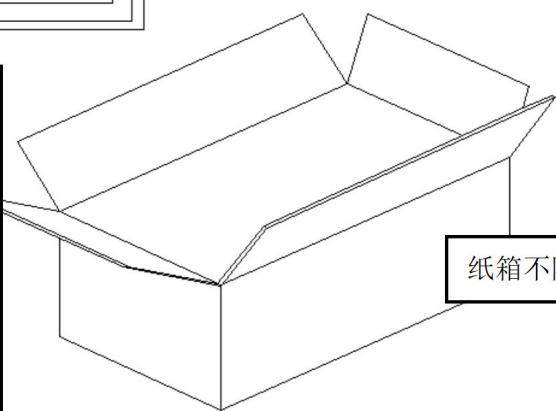
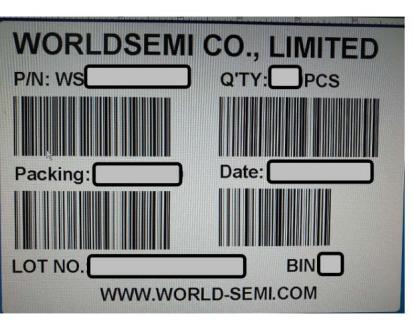
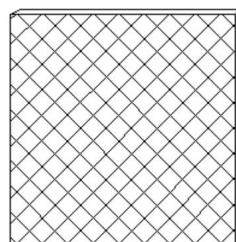


卷盘/包装袋
标签一致

防静电袋



产品与产品之间用
珍珠棉隔开, 运输过程保
护产品不受冲击



纸箱不防水, 注意防水防潮

表面贴装型 LED 使用注意事项

1. 描述:

通常 LED 也像其它的电子元件一样有着相同的使用方法，为了让客户更好地使用华彩威的 LED 产品，请参看下面的 LED 保护预防措施。

2. 注意事项:

2. 1. 灰尘与清洁

LED 的表面是采用改性环氧胶封装的，环氧胶对于 LED 的光学系统和抗老化性能都起到很好的保护作用。环氧胶易粘灰尘，保持作业环境的洁净。当 LED 表面有一定限度内的尘埃，也不会影响到发光亮度，但我们仍应避免尘埃落到 LED 表面。打开包装袋的就优先使用，安装过 LED 的组件应存放在干净的容器中，在 LED 表面需要清洁时，如果使用三氨乙烯或者丙酮等溶液会出现使 LED 表面溶解等现象，不可使用具用溶解性的溶液清洁 LED，可使用一些异丙基的溶液，在使用任何清洁溶液之前都应确认是否会对 LED 有溶解作用；请不要用超声波的方法清洁 LED，如果产品必须使用超声波，那么就要评估影响 LED 的一些参数，如超声波功率，烘烤的时间和装配的条件等，在清洁之前必须试运行，确认是否会影响到 LED。

2. 2. 防潮包装

LED 属于湿敏元件，将 LED 包装在铝膜的袋中是为了避免 LED 在运输和储存时吸收湿气，在包装袋中放有干燥剂，以吸收湿气。如果 LED 吸收了水气，那么在 LED 过回流焊时，水气就会蒸发而膨胀，有可能使胶体与支架脱离以及损害 LED 的光学系统。由于这个原因，防湿包装是为了使包装袋内避免有湿气，但通常保护时间仅能维持 1~2 个月。此款产品防潮等级 (MSL) 为：5a. SMT 时请参照 IPC/JEDECJ-STD-020 规定的材料防潮等级 (MSL) 定义进行 MSL 管控。

防潮等级	包装拆封后车间寿命	
	时间	条件
LEVEL1	无限制	≤30°C / 85%RH
LEVEL2	1 年	≤30°C / 60%RH
LEVEL2a	4 周	≤30°C / 60%RH
LEVEL3	168 小时	≤30°C / 60%RH
LEVEL4	72 小时	≤30°C / 60%RH
LEVEL5	48 小时	≤30°C / 60%RH
LEVEL5a	24 小时	≤30°C / 60%RH
LEVEL6	取出即用	≤30°C / 60%RH

2.3 SMT 贴片说明：

2.3.1 建议 LED 在 SMT 前拆袋，整卷放入烤箱中进行除湿干燥（70~75℃烘烤≥24H）；

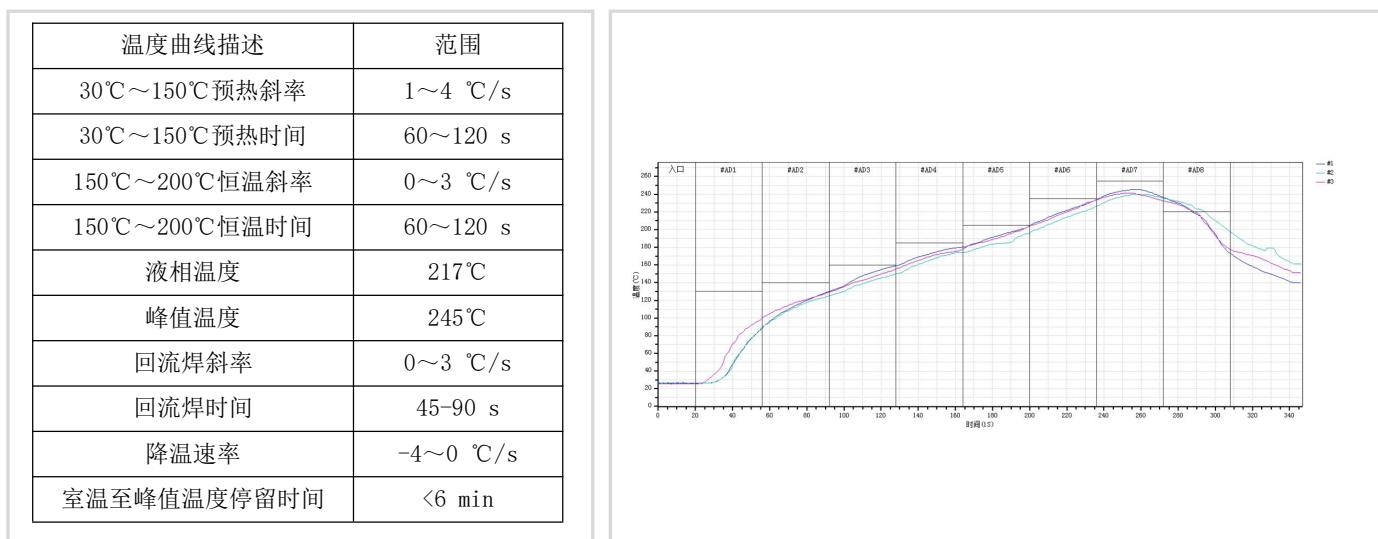
2.3.2 产品从烤箱中取出至高温焊接完成（包含多次回流焊、浸锡、波峰焊、加热维修等高温操作/作业），时间段控制在 24 小时内（在 T<30℃，RH<60%条件下）；

2.3.3 LED 贴件在印刷锡膏后的 PCBA 上，应尽快完成 SMT，建议不超过 1H；

2.3.4 生产剩余、机台抛料、维修用料等散料 LED，若长时间暴露在空气中，不可直接使用，建议进行除湿干燥后再被使用。整卷烘烤：70~75℃* ≥24H 或 散料烘烤：120℃*4H。

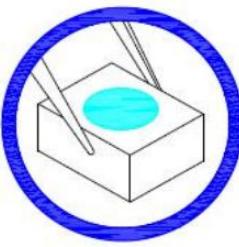
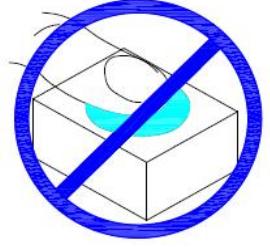
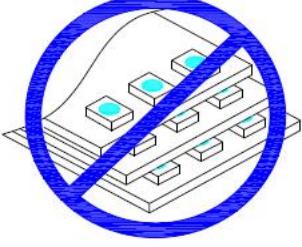
3. 焊接

表贴应用 LED 应符合 JEDECJ-STD-020C 标准，作为一般指导原则，建议遵循所用焊锡膏制造商推荐的焊接温度曲线，或使用我司如下推荐的焊接温度曲线。



注：1. 以上所有温度是指在封装本体上表面测的温度

4. 产品配装过程注意事项

1. 通过使用适当的工具从材料侧面夹取	2. 不可直接用手或尖锐金属压胶体表面，它可能会损坏内部电路	3. 不可将模组材料堆积在一起，它可能会损坏内部电路	4. 不可用在 PH<7 的酸性场所
			



WS2850B-BRG1
5050 RGB 三合一 LED

文件更改记录

版本号	状态	修改内容概要	修订日期	修订人	批准人
V1.0	N	新建	20230531	胡锦	尹华平

注：初始版本号V1.0；每次修订批准后，版本号顺序加“0.1”；

状态包括：N--新建，A--增加，M--修改，D--删除。